

プリント基板設計からの取り組みで、
実装条件の最適化・実装効率の最大化が実現できます。



対応はんだ

	鉛フリー (Sn-3Ag-0.5Cu)	共晶 (Sn-Pb)	銀レス (Sn-0.05Ni-0.4Cu-0.01Ge)
表面実装	○	○	○
フローはんだ	○	○	○
ポイントはんだ	○	-	-
手はんだ	○	○	○

*表面実装はハロゲンフリー対応可

対応可能な基板サイズ

LL基板用	フローはんだ付け対応 <small>LLサイズ基板用フロー装置保有 (500mm×510mm)</small>
L基板用	チップ実装対応 <small>Lサイズ基板用リフロー装置保有</small>
M基板用	ポイントはんだ付け対応

対応可能加工・周辺技術

- 実装解析
- BGAリペア
- X線検査
- コーティング
- ポッティング
- シリコン塗布
- テーピング
- 基板自動分割
- 実装ラボルーム
- クリーンルーム
- 治具製造ルーム